

# ICT舗装工の導入(H29.4~)

- 更なる生産性向上を目指して、舗装工にICTを全面的に導入する「ICT舗装」を平成29年度より取組開始
- 必要となる技術基準や積算基準を平成28年度に整備、平成29年4月以降の工事に適用



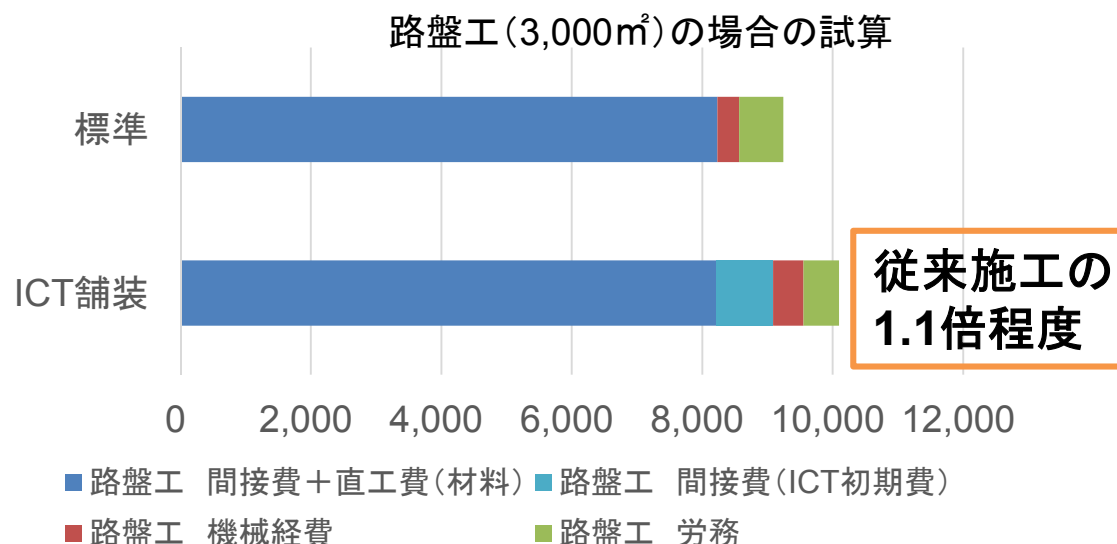
# ICT舗装の発注方針及び積算基準の新設

- ICT舗装の発注は新設舗装工事を対象とし、発注方針は以下の通り。
  - ① 予定価格3億円以上の10,000m<sup>2</sup>以上の路盤工を含む工事は、ICT舗装の実施を指定し発注。(発注者指定型)
  - ② 3億円未満で10,000m<sup>2</sup>以上の路盤工を含む工事は入札時に総合評価で加点。(施工者希望 I 型)
  - ③ 規模に関わらず、受注者の提案・協議によりICT舗装を実施可能。(施工者希望 II 型等)
  - ④ 全てのICT舗装において、ICT建機等の活用に必要な費用を計上し、工事成績評点で加点評価。

※地域の状況によっては上記によらない場合がある

## 【新たな積算基準のポイント】

- ①新たに追加等する項目
  - ・ICT機器のリース料  
(従来建機からの増分)
  - ・ICT建機の初期導入経費
- ②従来施工から変化する項目
  - ・補助労務の省力化に伴う減
  - ・効率化に伴う日あたり施工量の増



## □ 舗装工の生産性向上を図る上で必要な10の技術基準類を新設・改訂する。

名称		改訂/ 新設	本文参照先・概要
施工	ICTの全面的な活用の実施方針	改訂	<a href="http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html">http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html</a> ・ICT舗装工の定義やインセンティブ措置等
	土木工事数量算出要領(案)	改訂	<a href="http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/sr/yoryo2904.htm">http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/sr/yoryo2904.htm</a> ・3次元起工測量結果から、路盤工の平均厚さ区分の「平均厚さ」算出方法を記載
	土木工事施工管理基準(案) (出来形管理基準及び規格値)	改訂	<a href="http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html">http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html</a> ・路盤～表層に面管理を導入し、全数管理に応じた規格値の設定 ・厚さの管理項目を「目標高さ」管理への代替を可能とする。 ・個々の計測値に対する規格値を面計測による計測密度(多点観測)をふまえて改訂
	地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)	新設	<a href="http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html">http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html</a> ・ICT舗装工の面管理に必要な計測精度となるような精度確認ルール等を策定
	TSを用いた出来形管理要領(舗装工事編)	改訂	<a href="http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html">http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html</a> ・新設舗装において厚さを管理可能とする改訂
	写真管理基準(案)	改訂	<a href="http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html">http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html</a> ・新たに追加した出来形管理要領名称(地上型レーザースキャナー(舗装工事)、TS(舗装工事))の追記
検査	地方整備局土木工事検査技術基準(案)	改訂	<a href="http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html">http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html</a> ・面管理に伴う検査密度の規定の変更 (地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案)にをふまえた修正)
	既済部分検査技術基準(案)及び同解説	改訂	<a href="http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html">http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html</a> ・面管理に伴う検査密度の規定の変更(地方整備局土木工事検査技術基準(案)に準じた変更)
	地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案)	新設	<a href="http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html">http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html</a> ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)に合わせて策定
	TSを用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)	改訂	<a href="http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html">http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html</a> ・TSを用いた出来形管理要領(舗装工事編)をふまえた修正
積算基準	ICT活用工事(舗装工)積算要領	新設	<a href="http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html">http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html</a> ・施工パッケージ化対応